

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
1076-4-101**

QC 480301XX0002

Première édition
First edition
1995-05

**Connecteurs sous assurance de la qualité,
pour utilisation dans le cadre d'applications analogiques
en courant continu et à basse fréquence et dans le cadre
d'applications numériques utilisant des débits élevés
pour le transfert des données –**

Partie 4:

Connecteurs pour cartes imprimées –

**Section 101: Spécification particulière pour modules
de connecteurs en deux parties pour cartes imprimées et
fonds de panier au pas de base de 2,0 mm selon la CEI 917**

**Connectors with assessed quality, for use in d.c.
low-frequency analogue and in digital high speed
data applications –**

Part 4:

Printed board connectors –

**Section 101: Detail specification for two-part connector
modules having a basic grid of 2,0 mm for printed boards
and backplanes in accordance with IEC 917**

© CEI 1995 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun pro-
cédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et
les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in
any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and microfilm, without permission
in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS.....	6
Articles	
1 Données générales.....	10
1.1 Méthode recommandée pour le montage.....	10
1.1.1 Nombre de contacts et d'alvéoles pour contacts.....	10
1.2 Caractéristiques et conditions nominales de fonctionnement.....	12
1.3 Références normatives.....	12
1.4 Marquage.....	14
1.5 Désignation de type CEI.....	16
1.6 Références pour les commandes.....	18
2 Données techniques.....	18
2.1 Définitions.....	18
2.1.1 Eléments mécaniques.....	18
2.1.2 Contacts et sorties.....	18
2.1.3 Accouplement séquentiel.....	20
2.1.4 Codage mécanique.....	20
2.2 Tableaux des modèles et des variantes.....	22
2.2.1 Modèles de modules de connecteurs.....	22
2.2.2 Tableau des types de sortie.....	24
2.2.3 Tableau des clefs de codage.....	24
2.3 Renseignements sur l'application.....	26
2.3.1 Connecteurs complets (paires).....	26
2.3.2 Embases.....	28
2.3.3 Fiches.....	30
2.3.4 Accessoires.....	30
2.3.5 Blindage et continuité de masse.....	34
2.3.6 Type de sorties.....	36
2.4 Arrangements des contacts.....	38
3 Renseignements concernant les dimensions.....	42
3.1 Généralités.....	42
3.2 Vue isométrique et caractéristiques communes.....	42
3.2.1 Caractéristiques communes.....	44
3.2.2 Système de référence.....	44
3.2.3 Dimensions en hauteur.....	44
3.2.4 Dimensions en largeur.....	46
3.2.5 Dimensions en profondeur.....	48
3.3 Renseignements concernant l'accouplement.....	48
3.3.1 Direction de l'accouplement.....	48
3.3.2 Ecart perpendiculaire à la direction d'accouplement.....	50
3.3.3 Inclinaison.....	50
3.4 Embases.....	52
3.4.1 Dimensions des modules de connecteurs.....	52
3.4.2 Dimensions des contacts.....	62
3.4.3 Sorties.....	64
3.5 Connecteurs fiches.....	68
3.5.1 Dimensions des modules de fiche.....	68
3.5.2 Dimensions des contacts.....	80
3.5.3 Sorties.....	82

CONTENTS

	Page
FOREWORD	7
Clause	
1 General data	11
1.1 Recommended method of mounting	11
1.1.1 Number of contacts and contact cavities	11
1.2 Ratings and characteristics	13
1.3 Normative references	13
1.4 Marking	15
1.5 IEC type designation	17
1.6 Ordering information	19
2 Technical data	19
2.1 Definitions	19
2.1.1 Mechanical features	19
2.1.2 Contacts and terminations	19
2.1.3 Engagement sequence	21
2.1.4 Mechanical coding	21
2.2 Survey of styles and variants	23
2.2.1 Styles of connector modules	23
2.2.2 Survey of termination variants	25
2.2.3 Survey of coding devices	25
2.3 Information on application	27
2.3.1 Complete connectors (pairs)	27
2.3.2 Fixed board connectors	29
2.3.3 Free board connectors	31
2.3.4 Accessories	31
2.3.5 Shielding and grounding	35
2.3.6 Basic type of termination	37
2.4 Contact arrangements	39
3 Dimensional information	43
3.1 General	43
3.2 Isometric view and common features	43
3.2.1 Common features	45
3.2.2 Reference system	45
3.2.3 Height dimensions	45
3.2.4 Width dimensions	47
3.2.5 Depth dimensions	49
3.3 Mating information	49
3.3.1 Engaging direction	49
3.3.2 Perpendicular to engaging direction	51
3.3.3 Inclination	51
3.4 Fixed board connectors	53
3.4.1 Dimensions of connector modules	53
3.4.2 Dimensions of contacts	63
3.4.3 Terminations	65
3.5 Free board connectors	69
3.5.1 Dimensions of connector modules	69
3.5.2 Dimensions of contacts	81
3.5.3 Terminations	83

Articles	Pages
3.6 Accessoires	84
3.6.1 Dimensions des clefs de codage	84
3.7 Renseignements sur le montage des embases	88
3.8 Renseignements sur le montage des fiches	100
3.9 Calibres	112
3.9.1 Calibre de forçage et de force de rétention	112
3.9.2 Calibre de vérification du premier point de contact possible	114
4 Caractéristiques	116
4.1 Catégories climatiques	116
4.2 Electriques	116
4.2.1 Lignes de fuite et distances dans l'air	116
4.2.2 Tension de tenue	116
4.2.3 Courant limite admissible	118
4.2.4 Résistance de contact	118
4.2.5 Résistance d'isolement	120
4.3 Mécaniques	120
4.3.1 Manoeuvres mécaniques	120
4.3.2 Forces d'accouplement et de désaccouplement	120
4.3.3 Rétention du contact dans l'isolant	120
4.3.4 Charge statique transversale	122
4.3.5 Force de rétention du calibre	122
4.3.6 Vibrations (sinusoïdales)	122
4.3.7 Chocs	124
4.3.8 Méthode de polarisation	124
4.3.9 Robustesse et efficacité des dispositifs de codage	124
5 Programme d'essais	126
5.1 Généralités	126
5.1.1 Disposition pour la mesure de la résistance de contact	128
5.1.2 Disposition pour les essais de contraintes dynamiques	128
5.1.3 Disposition pour l'essai de la charge statique transversale	130
5.1.4 Disposition pour la tension de tenue et la tension de polarisation	130
5.1.5 Disposition pour l'essai d'inflammabilité	130
5.2 Tableaux des programmes d'essais	132
5.2.1 Groupe P – Préliminaire	132
5.2.2 Groupe A – Dynamique/Climatique	134
5.2.3 Groupe B – Endurance mécanique	138
5.2.4 Groupe C – Humidité	140
5.2.5 Groupe D – Charge électrique	140
5.2.6 Groupe E – Résistance mécanique	142
5.2.7 Groupe F – Résistance chimique	142
5.2.8 Groupe G – Connexions	142
6 Procédures d'assurance de la qualité	144
6.1 Procédure d'homologation	144
6.1.1 Méthode 1	144
6.1.2 Méthode 2	144
6.2 Contrôle de la conformité de la qualité	146
6.2.1 Essais lot par lot	146
6.2.2 Essais périodiques	146
6.3 Livraison différée, nouvelles inspections	148
Annexe A (normative) – Atmosphère industrielle	150
Annexe B (informative) – Vues en perspective de tous les modèles	152
Annexe C (informative) – Contacts spéciaux Ø 4,8 mm	156
Annexe D (informative) – Numéros de code et références des couleurs	160

Clause	Page
3.6 Accessories	85
3.6.1 Dimensions of coding devices	85
3.7 Mounting information for fixed board connectors	89
3.8 Mounting information for free board connectors	101
3.9 Gauges	113
3.9.1 Sizing gauges and retention force gauges	113
3.9.2 Test gauge for first contact point	115
4 Characteristics	117
4.1 Climatic category	117
4.2 Electrical	117
4.2.1 Creepage and clearance distances	117
4.2.2 Voltage proof	117
4.2.3 Current-carrying capacity	119
4.2.4 Contact resistance	119
4.2.5 Insulation resistance	121
4.3 Mechanical	121
4.3.1 Mechanical operation	121
4.3.2 Engaging and separating forces	121
4.3.3 Contact retention in insert	121
4.3.4 Static load, transverse	123
4.3.5 Gauge retention force	123
4.3.6 Vibration (sinusoidal)	123
4.3.7 Shock	125
4.3.8 Polarizing method	125
4.3.9 Robustness and effectiveness of coding devices	125
5 Test schedule	127
5.1 General	127
5.1.1 Arrangement for contact resistance measurement	129
5.1.2 Arrangement for dynamic stress tests	129
5.1.3 Arrangement for testing static load, transverse	131
5.1.4 Arrangement for voltage proof and polarization voltage	131
5.1.5 Arrangement for flammability test	131
5.2 Test schedule tables	133
5.2.1 Group P – Preliminary	133
5.2.2 Group A – Dynamic / Climatic	135
5.2.3 Group B – Mechanical endurance	139
5.2.4 Group C – Moisture	141
5.2.5 Group D – Electrical load	141
5.2.6 Group E – Mechanical resistivity	143
5.2.7 Group F – Chemical resistivity	143
5.2.8 Group G – Connections	143
6 Quality assessment procedures	145
6.1 Qualification approval	145
6.1.1 Method 1	145
6.1.2 Method 2	145
6.2 Quality conformance inspection	147
6.2.1 Lot-by-lot tests	147
6.2.2 Periodic tests	147
6.3 Delayed delivery, re-inspection	149
Annex A (normative) – Industrial atmosphere	151
Annex B (informative) – Perspective views of all styles	153
Annex C (informative) – Special contacts Ø 4,8 mm	157
Annex D (informative) – Code numbers and colour references	161

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**CONNECTEURS SOUS ASSURANCE DE LA QUALITÉ,
POUR UTILISATION DANS LE CADRE D'APPLICATIONS ANALOGIQUES
EN COURANT CONTINU ET À BASSE FRÉQUENCE ET DANS LE CADRE
D'APPLICATIONS NUMÉRIQUES UTILISANT DES DÉBITS ÉLEVÉS
POUR LE TRANSFERT DES DONNÉES –**

**Partie 4 : Connecteurs pour cartes imprimées –
Section 101: Spécification particulière pour modules de connecteurs
en deux parties pour cartes imprimées et fonds de panier
au pas de base de 2,0 mm selon la CEI 917**

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.

La Norme internationale CEI 1076-4-101 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs, du comité d'études 48 de la CEI: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants :

DIS	Rapport de vote
48B(BC)253	48B/397/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

L'annexe A fait partie intégrante de la norme.

Les annexes B, C et D sont données uniquement à titre d'information.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de spécification dans le Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**CONNECTORS WITH ASSESSED QUALITY,
FOR USE IN DC LOW-FREQUENCY ANALOGUE
AND IN DIGITAL HIGH SPEED DATA APPLICATIONS –****Part 4: Printed board connectors –
Section 101: Detail specification for two-part connector modules
having a basic grid of 2,0 mm for printed boards and backplanes
in accordance with IEC 917**

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.

International Standard IEC 1076-4-101 has been prepared by subcommittee 48B: Connectors, of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for electronic equipment.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS	Report on voting
48B(CO)253	48B/397/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

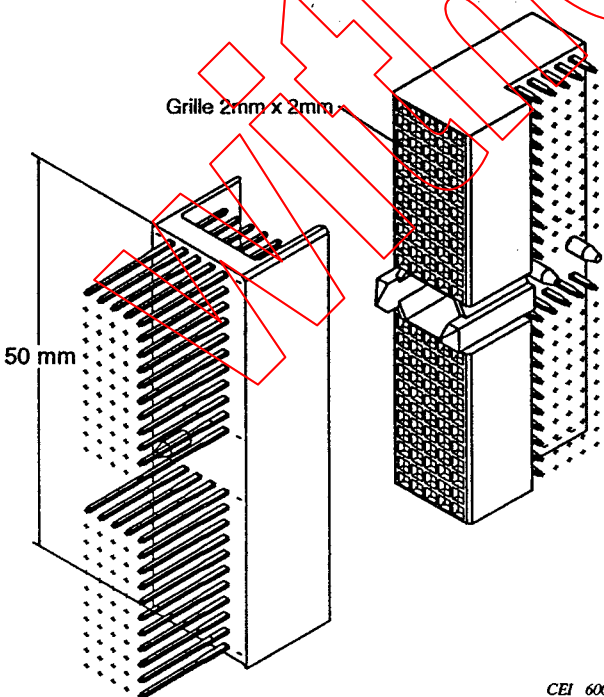
Annex A forms an integral part of this standard.

Annexes B, C and D are for information only.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

**CONNECTEURS SOUS ASSURANCE DE LA QUALITÉ,
POUR UTILISATION DANS LE CADRE D'APPLICATIONS ANALOGIQUES
EN COURANT CONTINU ET À BASSE FRÉQUENCE ET DANS LE CADRE
D'APPLICATIONS NUMÉRIQUES UTILISANT DES DÉBITS ÉLEVÉS
POUR LE TRANSFERT DES DONNÉES -**

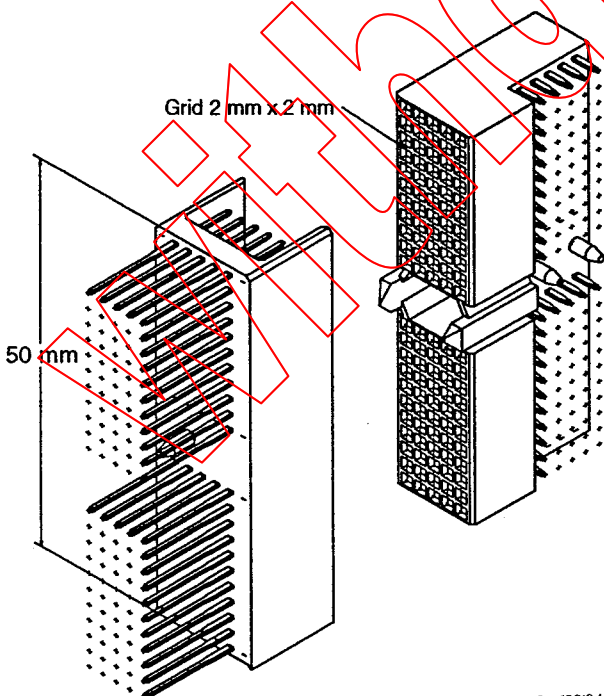
**Partie 4 : Connecteurs pour cartes imprimées -
Section 101: Spécification particulière pour modules de connecteurs
en deux parties pour cartes imprimées et fonds de panier
au pas de base de 2,0 mm selon la CEI 917**

CEI SC 48B – Connecteurs Spécification disponible auprès de: Bureau Central CEI ou aux adresses indiquées sur la couverture intérieure. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES DE QUALITÉ ASSURÉE SPÉCIFICATION PARTICULIÈRE conforme à la norme CEI 1076-1, 48B/363/DIS, février 1995	CEI 1076-4-101 QC 480301XX0002
 CEI 600194	Modules de connecteurs en deux parties pour cartes imprimées et fonds de panier, au pas de base de 2,0 mm, selon la CEI 917.
	Modules de connecteurs juxtaposables bout à bout, à cinq rangées, longs de 50 mm (et 25 mm), avec codage, blindage et contacts spéciaux en option.
	Niveaux de performance (NP): 1, 2, 3 Niveaux de contrôle: A et G Combinaisons de niveaux de performance et de contrôle: 1G, 2A, 2G, 3A.

Les informations concernant les fabricants capables de fournir les composants conformes à cette spécification particulière sont fournies dans la Liste des produits qualifiés.

**CONNECTORS WITH ASSESSED QUALITY,
FOR USE IN DC LOW-FREQUENCY ANALOGUE
AND IN DIGITAL HIGH SPEED DATA APPLICATIONS –**

**Part 4: Printed board connectors –
Section 101: Detail specification for two-part connector modules
having a basic grid of 2,0 mm for printed boards and backplanes
in accordance with IEC 917**

IEC SC 48B – Connectors Specification available from: IEC Central Office or from the addresses shown on the inside cover. ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QUALITY DETAIL SPECIFICATION in accordance with IEC 1076-1 Draft 48B/363/DIS, February 1995	IEC 1076-4-101 QC 480301XX0002
 Grid 2 mm x 2 mm 50 mm IEC 600194	Two-part connector modules for printed boards and backplanes, grid of 2 mm in accordance with IEC 917.
	Stackable connector modules, five rows, 50 mm (and 25 mm) long, with optional coding, shielding and cavities for special contacts.
	Performance levels (PL): 1, 2, 3 Assessment levels: A and G Combinations of performance and assessment levels: 1G, 2A, 2G, 3A.

Information on the availability of components qualified to this detail specification is given in the Qualified products list.

1 Données générales

Dans toute cette spécification les dimensions sont exprimées en millimètres.

1.1 Méthode recommandée pour le montage

Un connecteur complet consiste en un ou plusieurs modules de connecteurs, qui sont juxtaposables bout à bout, sans perte de contacts.

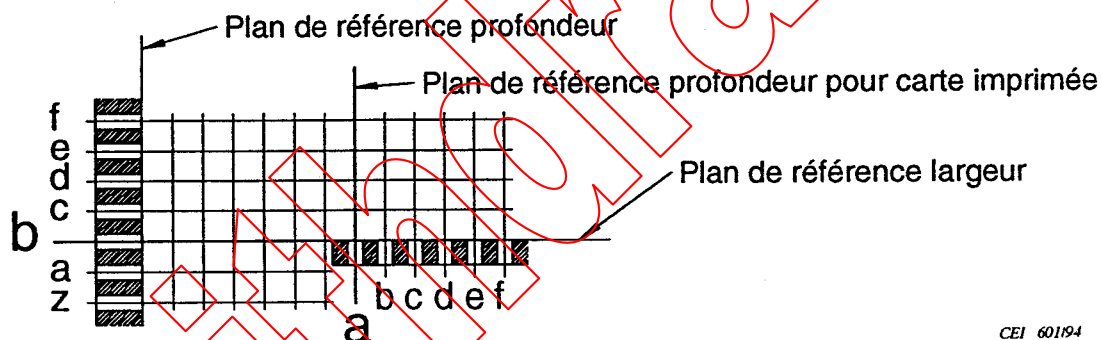
Les dispositifs de guidage, de codage, et de fixation sont groupés dans un bloc multi-fonctions (nommé BMF dans toute cette spécification). Les modules de fiche sont montés sur le bord de la carte imprimée, et sont équipés de contacts femelles aux sorties coudées CIF (connection insérée de force).

Les modules d'embase sont montés sur le fond de panier, et sont équipés de contacts mâles aux sorties droites CIF avec bornes pour connexions enroulées et/ou contacts de reprise arrière en option.

L' intervalle entre le fond de panier et le bord de carte imprimée est de 12,5 mm.

L'axe des contacts b sur le fond de panier est en ligne avec le plan de référence en «largeur» de la carte imprimée.

L'axe des sorties a, sur la carte imprimée, est à 1,5 mm du bord, et à 14 mm du fond de panier.



CEI 60184

Figure 1 – Conception de grille pour modules de connecteurs 2 mm

1.1.1 Nombre de contacts et d'alvéoles pour contacts

Les modules de connecteurs ont cinq rangées de contacts, et deux rangées de continuité de masse en option, qui peuvent être équipées entièrement ou partiellement. Les modules de 50 mm de long peuvent contenir jusqu'à 125 contacts et 50 contacts de continuité de masse supplémentaires.

Tableau 1 – Nombre d'alvéoles pour contacts, par modèle

Modèle (voir 2.2.1)	A	B	C	L	M	N
Alvéoles pour contacts	110	125	55	–	55	–
Alvéoles pour contacts de masse	44	50	22	–	22	–
Alvéoles pour contacts spéciaux	–	–	–	6	3	3

1 General data

Throughout this specification dimensions are in millimeters.

1.1 Recommended method of mounting

A complete connector consists of one or more connector modules which are stackable end to end, without loss of contact positions.

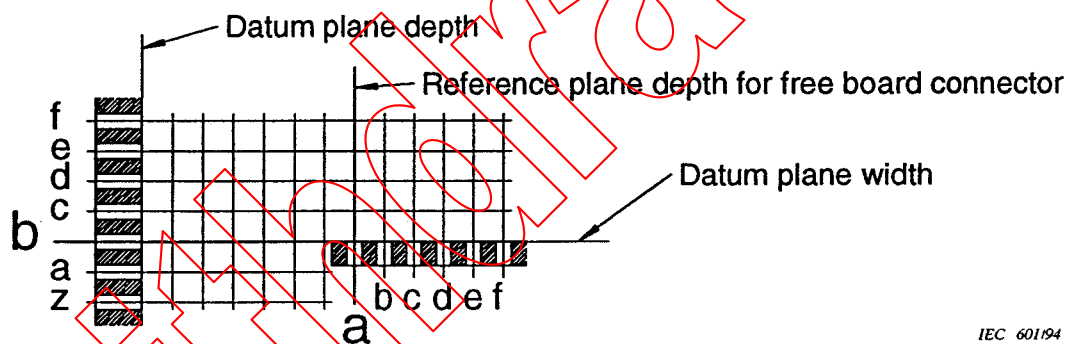
Guiding, coding, and mounting features are grouped in a multipurpose centre (called MPC throughout this specification). Free board connector modules are mounted on the edge of the printed circuit board, and have female contacts with angled press-in terminations.

Fixed board connector modules are mounted on the backplane, and have male contacts with straight press-in terminations with optional solderless wrapping and/or rear plug-up contacts.

The gap between the backplane and the edge of the printed board is 12,5 mm.

The contact row b on the backplane is in line with the reference plane "width" of the printed board.

The termination row a on the printed board lies 1,5 mm from the edge and 14 mm from the backplane.



IEC 60194

Figure 1 – Typical grid layout for 2 mm connector modules

1.1.1 Number of contacts and contact cavities

The connector modules have five contact rows, and two optional grounding rows, which can be fully or partially loaded. 50 mm connector modules can have up to a maximum of 125 signal contacts and 50 additional grounding contacts.

Table 1 – Number of contact cavities per style

Style (see 2.2.1)	A	B	C	L	M	N
Cavities for signal contacts	110	125	55	–	55	–
Cavities for grounding contacts	44	50	22	–	22	–
Cavities for special contacts	–	–	–	6	3	3

1.2 Caractéristiques et conditions nominales de fonctionnement

Tension nominale: contact/contact 500 V valeur efficace

Courant nominal: 1 A à 70 °C (tous contacts chargés)

Résistance d'isolement: 10⁴ MΩ min.

Catégories climatiques: PL1 : 55/125/56

PL2 : 55/125/21

PL3 : 55/125/00

Carte imprimée: diamètre du trou métallisé: 0,55 mm à 0,65 mm
épaisseur du fond de panier: 1,4 mm à 5,6 mm
épaisseur de la carte imprimée: 1,4 mm à 4,2 mm

1.3 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui en est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 1076. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes des accords fondés sur la présente partie de la CEI 1076 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes Internationales en vigueur.

CEI 68-1: 1988, *Essais d'environnement – Première partie: Généralités et guide*.
Amendement 1 (1992)

CEI 68-2-60/TTD: 1990, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai Ke: Essais de corrosion en atmosphère artificielle à très basse concentration de gaz polluant(s)*

CEI 352-1: 1983, *Connexions sans soudure – Première partie: Connexions enroulées sans soudure – Règles générales, méthodes d'essai et conseils pratiques*

CEI 352-5: 1995, *Connexions sans soudure – Cinquième partie: Connexions insérées de force: Règles générales, méthodes d'essai et conseils pratiques*

CEI 410: 1973, *Plans et règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs*

CEI 512-1: 1994, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Première partie: Généralités*

CEI 512-2: 1985, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Deuxième partie: Examen général, essais de continuité électrique et de résistance de contact, essais d'isolement et essais de contrainte diélectrique*

CEI 512-3: 1976, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Troisième partie: Essais de courant limite*

CEI 512-4: 1976, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Quatrième partie: Essais de contraintes dynamiques*

CEI 512-5: 1992, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Cinquième partie: Essais d'impact (composants libres), essais d'impact sous charge statique (composants fixes), essais d'endurance et essais de surcharge*

CEI 512-6: 1984, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Sixième partie: Essais climatiques et essais de soudure*

CEI 512-7: 1993, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 7: Essais de fonctionnement mécanique et essais d'étanchéité*

1.2 Ratings and characteristics

Rated voltage:	contact/contact 500 V r.m.s.
Current rating:	1 A at 70 °C (all signal contacts loaded)
Insulation resistance:	10 ⁴ MΩ min.
Climatic category:	PL1 : 55/125/56 PL2 : 55/125/21 PL3 : 55/125/00
Printed board:	hole diameter: plated-through hole 0,55 mm to 0,65 mm thickness of backplane: 1,4 mm to 5,6 mm thickness of printed board: 1,4 mm to 4,2 mm

1.3 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 1076. At the time of publication, the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this part of IEC 1076, are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 68-1: 1988, *Environmental testing – Part 1: General and guidance*.
Amendment 1 (1992)

IEC 68-2-60/TTD: 1990, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Ke: Corrosion tests in artificial atmosphere at very low concentration of polluting gas(es)*

IEC 352-1: 1983, *Solderless connections – Part 1: Solderless wrapped connections – General requirements, test methods and practical guidance*

IEC 352-5: 1995, *Solderless connections – Part 5: Solderless press-in connections – General requirements, test methods and practical guidance*

IEC 410: 1973, *Sampling plans and procedures for inspection by attributes*

IEC 512-1: 1994, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 1: General*

IEC 512-2: 1985, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 2: General examination, electrical continuity and contact resistance tests, insulation tests and voltage stress tests*

IEC 512-3: 1976, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 3: Current-carrying capacity tests*

IEC 512-4: 1976, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 4: Dynamic stress tests*

IEC 512-5: 1992, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 5: Impact tests (free components), static load tests (fixed components), endurance tests and overload tests*

IEC 512-6: 1984, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 6: Climatic tests and soldering tests*

IEC 512-7: 1993, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 7: Mechanical operating tests and sealing tests*

CEI 512-8: 1993, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 8: Essais mécaniques des connecteurs, des contacts et des sorties*

CEI 512-9: 1992, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 9: Essais divers*

CEI 917: 1988, *Ordre modulaire pour le développement des structures mécaniques pour les infrastructures électroniques.*

Amendement 1 (1992)

CEI 917-2-2: 1994, *Ordre modulaire pour le développement des structures mécaniques pour les infrastructures électroniques – Partie 2: Spécification intermédiaire – Dimensions de coordination d'interface pour les infrastructures au pas de 25 mm – Section 2: Dimensions pour bacs, châssis, panneaux arrière, faces avant et unités enfichables*

CEI 1076-1: 199X, *Connecteurs sous assurance de la qualité pour utilisation dans le cadre d'applications analogiques en courant continu et à basse fréquence et dans le cadre d'applications numériques utilisant des débits élevés pour le transfert des données – Partie 1: Spécification générique (à l'étude)*

CEI 1076-4: 199X, *Connecteurs sous assurance de la qualité pour utilisation dans le cadre d'applications analogiques en courant continu et à basse fréquence et dans le cadre d'applications numériques utilisant des débits élevés pour le transfert des données – Partie 4: Connecteurs pour cartes imprimées. Spécification intermédiaire (à l'étude)*

ISO 468: 1982, *Rugosité de surface – Paramètres, leurs valeurs et les règles générales de la détermination des spécifications*

Withdrawn

IEC 512-8: 1993, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 8: Connector tests (mechanical) and mechanical tests on contacts and terminations*

IEC 512-9: 1992, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 9: Miscellaneous tests*

IEC 917: 1988, *Modular order for the development of mechanical structures for electronic equipment practices.*

Amendment 1 (1992)

IEC 917-2-2: 1994, *Modular order for the development of mechanical structures for electronic equipment practices – Part 2: Sectional specification - Interface co-ordination dimensions for the 25 mm equipment practice – Section 2: Dimensions for subracks, chassis, backplanes, front panels and plug-in units*

IEC 1076-1: 199X, *Connectors with assessed quality, for use in d.c., low frequency analogue and in digital high speed data applications – Part 1: Generic specification (under consideration)*

IEC 1076-4: 199X, *Connectors with assessed quality, for use in d.c., low frequency analogue and in digital high speed data applications – Part 4: Printed board connectors: Sectional specification (under consideration)*

ISO 468: 1982, *Surface roughness – Parameters, their values and general rules for specifying requirements*

Withdawn